

# 2024-2030年中国IC先进 封装设备市场研究与发展趋势研究报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国IC先进封装设备市场研究与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R05/R0502/202404/29-613442.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

产业研究报告网发布的《2024-2030年中国IC先进封装设备市场研究与发展趋势研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

### 第一章 全球半导体产业

#### 第一节 全球半导体产业概况

#### 第二节 半导体产业供应链

#### 第三节 半导体封装简介

### 第二章 IC封装行业上、下游分析

#### 第一节 半导体产业地域格局

#### 第二节 半导体产业支出趋势

#### 第三节 DRAM内存产业

##### 一、DRAM内存产业现状

##### 二、DRAM内存厂家市场占有率

##### 三、移动DRAM内存厂家市场占有率

#### 第四节 NAND闪存

#### 第五节 晶圆代工产业

#### 第六节 晶圆代工行业竞争分析

#### 第七节 晶圆代工产业排名

#### 第八节 手机市场

#### 第九节 PC市场

#### 第十节 平板电脑市场

#### 第十一节 FPGA与CPLD市场

### 第三章 封测技术趋势

#### 第一节 WIDE IO/HMC MEMORY

#### 第二节 EMBEDDED COMPONENT SUBSTRATE

#### 第三节 EMBEDDED TRACE SUBSTRATE

#### 第四节 手持设备IC封装 IC PACKAGING FOR HANDSET

##### 一、手持设备IC封装现状

##### 二、POP封装

##### 三、FOWLP

#### 第五节 SIP封装

##### 一、MURATA

##### 二、环隆电气USI

#### 第六节 2.5D封装(SI/GLASS/ORGANIC INTERPOSER)

##### 一、2.5D封装简介

##### 二、2.5D封装应用

##### 三、2.5D INTERPOSER市场规模

##### 四、2.5D封装供应商

#### 第七节 TSV (3D) 封装

##### 一、TSV封装设备

### 第四章 封装设备产业分析

#### 第一节 封测产业规模

#### 第二节 MIDDLE-END中段封测产业

#### 第三节 封装设备市场规模

#### 第四节 封装设备市场占有率

#### 第五节 封装设备厂家排名

### 第五章 封装设备厂家研究

#### 第一节 ASM PACIFIC

#### 第二节 KULICKE & SOFFA

#### 第三节 BESI

#### 第四节 ADVANTEST

#### 第五节 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES

#### 第六节 TERADYNE

#### 第七节 DISCO

#### 第八节 TOWA

#### 第九节 HANMI

第十节 PFSA

第十一节 SUSS MicroTec

第十二节 Cohu&rsquo;s Semiconductor Equipment Group

第十三节 SHINKAWA

第十四节 TOKYO SEIMITSU

第十五节 ULTRATECH

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R05/R0502/202404/29-613442.html>